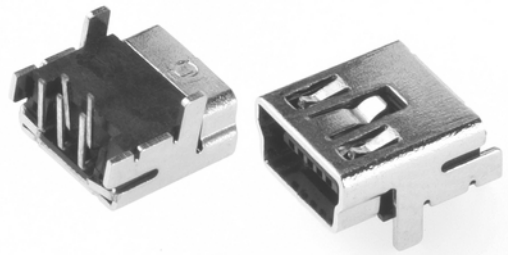


Mini-USB Steckverbinder, Typ B, Buchsen gerade/gewinkelt

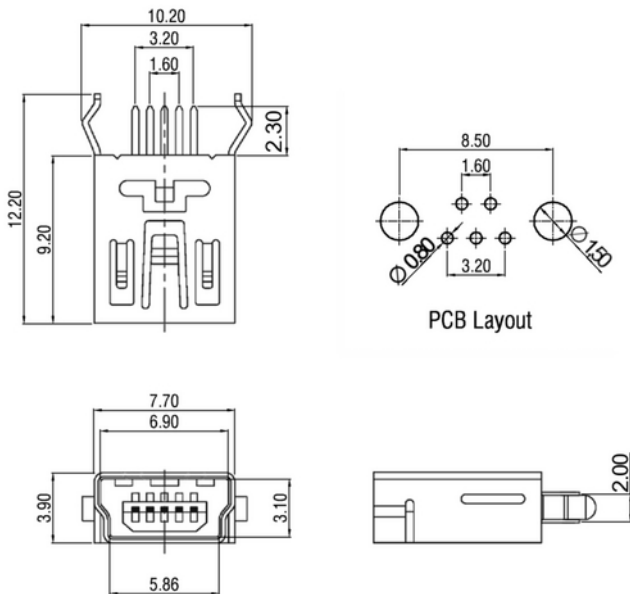
Mini-USB Connectors, Type B, Jacks Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing, verzinkt
Shell	Tin plated brass
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	Gold over nickel (see options below)
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	Tin plated over nickel
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 30mΩ
Contact Resistance	< 30mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennspannung	30V _{RMS}
Voltage Rating	30V _{RMS}
Nennstrom	1,5A bei 25°C
Current Rating	1,5A at 25°C
Temperaturbereich	-55°C ... +85°C
Temperature Range	-55°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



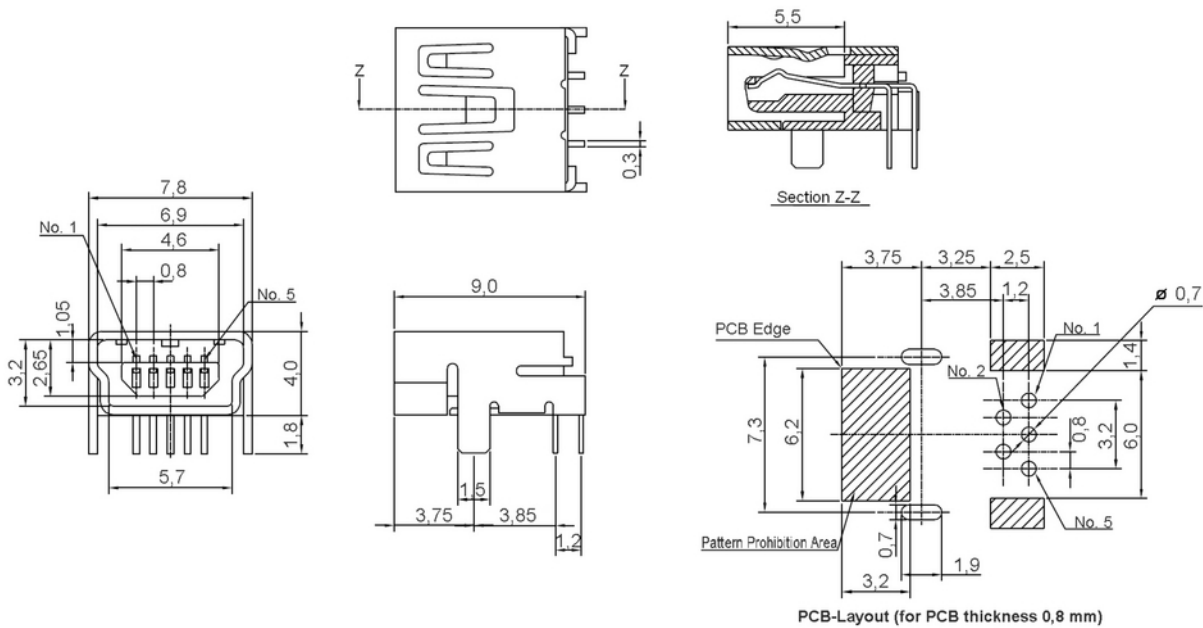
© W+P PRODUCTS



Series	Type	Contacts	Version*	Plating*
825	2 2 Type B (female)	05	1 1 Eingang oben Top entry	60 60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)

825

Mini-USB Steckverbinder, Typ B, Buchsen gerade/gewinkelt Mini-USB Connectors, Type B, Jacks Straight/Right-Angled



Series

825

Type

2

2 Type B (female)

Contacts

05

Version*

2

2 Eingang seitlich
Side entry

Plating*

80

60 Sel. Au/Sn
80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Löttempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

